

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023 年半年度业绩说明会)

编号：2023-007

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	参加公司 2023 年半年度业绩说明会的全体投资者
活动时间	2023 年 8 月 31 日 15:00—16:00
活动地点	价值在线（www.ir-online.cn）
上市公司接待 人员姓名	独立董事 蔺智挺 副总经理 林文浩 董事会秘书 奚颢 财务总监 闫柳 投资者关系经理 齐博
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>1、问：请简要介绍一下公司 2023 年上半年的经营情况。</p> <p>答：今年上半年，公司实现营业总收入 55,718.44 万元，较上年同期增长 20.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,204.27 万元，较上年同期下降 11.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,305.31 万元，较上年同期下降 12.23%，主要系公司产能持续扩充推升营业收入及成本，同时 2023 年一季度受半导体行业整体景气</p>

度影响，客户订单饱和度有所下降导致单位成本有所上升，营业成本变动率大于营业收入造成盈利水平整体有所下降。

自 2023 年 3 月起，随着行业景气度的触底反弹，公司订单趋势快速回暖，产能利用率快速提升，公司 2023 年二季度实现营业收入 31,580.67 万元，环比提升 30.84%；2023 年二季度实现归属于上市公司股东的净利润 5,574.11 万元，环比提升 111.93%，单季度营业收入及归属于上市公司股东的净利润均创历史新高，盈利能力环比显著改善，景气度修复、产能扩充对于公司市场份额及经营业绩的提升效果较为显著。

2、问：在营收增长 20%的情况下，为什么利润反而下降了 11%？

答：主要系公司产能持续扩充推升营业收入及成本，同时 2023 年一季度受半导体行业整体景气度影响，客户订单饱和度有所下降导致单位成本有所上升，营业成本变动率大于营业收入造成盈利水平整体有所下降。

3、问：上半年研发投入多少？占比多少？

答：公司 2023 年上半年研发费用 3,735.47 万元，研发投入占营业收入的比例为 6.70%。

4、问：显示驱动芯片封装测试的技术壁垒在哪？贵司这方面有什么核心竞争力？

答：凸块制造技术是高端先进封装的代表性技术之一，它通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，反应了先进制程以“以点代线”的发展趋势。凸块制造技术的重要性在于它是各类先进封装技术得以实现进一

步发展演化的基础，广泛应用于 FC、WLP、CSP、3D 等先进封装。

我公司金凸块制造技术基于黄金的优质属性，具有极细间距、高引脚密度、低感应、散热能力佳、导电性好、可靠性高等优势，可满足客户轻、薄、极细间距、高集成度与强耐氧化性的芯片封装需求，也是后段倒装封装（FlipChip）工艺（即 COG 和 COF）得以实现的关键技术，具有较高的技术壁垒。

公司目前在显示驱动芯片领域中的应用的金凸块制造工艺可在单颗长约 30mm、宽约 1mm 芯片上生成 4,000 余金凸块，在 12 吋晶圆上生成 900 万余金凸块，可实现金凸块宽度与间距最小至 6 μm ，并且把整体高度在 15 μm 以下的数百万金凸块高度差控制在 2.5 μm 以内。

5、问：公司上半年毛利率情况大概是怎么样？

答：公司上半年综合毛利率 24.01%，其中二季度单季综合毛利率 26.73%，与今年一季度相比环比提升 6.28 个百分点。2023 年一季度内显示驱动芯片市场整体延续了 2022 年下半年的低迷行情，自 2023 年 3 月份起随着下游库存去化进入尾声，叠加大尺寸面板需求逐步复苏，公司订单回暖，产能利用率快速提升，盈利能力环比显著改善；同时，公司持续调整产品结构、提升精细化管理水平，经营业绩的提升效果较为显著。

6、问：目前 12 吋显示驱动芯片封测产能情况如何？在建项目进度？

答：12 吋产能公司按照发展规划并根据下游需求稳健扩充。IPO 募投“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”预计今年年底实施完毕，“研发中心建设项目”预计今年 9 月份

	<p>实施完毕，其他在建项目进度也在有序推进当中，具体进度以公司公告为准。</p> <p>7、问：OLED 与 LCD 的驱动芯片在封测环节有什么技术差异？公司目前的技术能够满足多少种制程的显驱芯片？</p> <p>答：OLED 驱动芯片在晶圆测试时长和对测试机性能要求等方面都要高于 LCD；另外由于 OLED 芯片高介电层绝缘层的等效氧化物厚度较薄，在凸块制造和研磨切割当中对工艺和设备的要求也要高于 LCD。</p> <p>在显驱芯片领域，晶圆厂不同芯片线宽对封测工艺的要求相差不大，目前显驱芯片主流应用的制程公司均已覆盖，包括 28-150nm 线宽制程。</p> <p>8、问：请介绍一下，下半年的订单量情况。</p> <p>答：公司订单能见度一般 2-3 个月左右，目前在手订单饱和度较高。</p>
附件清单（如有）	无
上传日期	2023 年 9 月 1 日